

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 19 年 11 月 8 日 (2007.11.8)

【公開番号】特開 2002-110618 (P2002-110618A)
 【公開日】平成 14 年 4 月 12 日 (2002.4.12)
 【出願番号】特願 2000-294862 (P2000-294862)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/304 (2006.01)

B 0 8 B 3/02 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/304 6 5 1 B

H 0 1 L 21/304 6 4 3 A

B 0 8 B 3/02 C

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 9 月 26 日 (2007.9.26)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】スピン処理装置及び基板の処理方法

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 基板を保持して回転させることで処理するスピン処理装置において、
 駆動源と、
 この駆動源によって回転駆動される回転体と、
 この回転体に回転可能に設けられた歯車と、
 上記歯車に噛合する歯面を有し、歯車の回転によって歯車の接線方向に直線移動可能に
 設けられた複数の可動体と、
 各可動体にこの可動体の移動方向に沿って設けられ一端部に上記基板の周辺部を保持す
 る保持部を有する第 1 の杆状部材と、
 上記歯車と上記回転体とを連結し歯車を所定の回転方向に弾性的に付勢して上記保持部
 が上記基板の周辺部を保持する方向に上記可動体を移動させる付勢手段と
 を具備したことを特徴とするスピン処理装置。

【請求項 2】 上記第 1 の杆状部材の他端には、基板の回転によって上記保持部に発
 生する遠心力を相殺もしくは上記保持部を基板に圧接する方向に付勢するためのウエイト
 が設けられていることを特徴とする請求項 1 記載のスピン処理装置。

【請求項 3】 上記回転体には、先端に上記保持部に保持された基板の周辺部の下面
 を支持する支持部が設けられた複数の第 2 の杆状部材の他端が周方向に所定間隔で連結さ
 れていることを特徴とする請求項 1 記載のスピン処理装置。

【請求項 4】 上記回転体の外径寸法は、上記基板の外径寸法に比べて十分小さく形
 成されていることを特徴とする請求項 1 記載のスピン処理装置。

【請求項 5】 基板を保持して回転させることで処理する基板の処理方法において、
 請求項 1 に記載されたスピン処理装置を用いて上記基板を処理することを特徴とする基

板の処理方法。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0001

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0001】

【発明の属する技術分野】

この発明は基板を回転させながら洗浄処理したり、乾燥処理するためのスピン処理装置及びそのスピン処理装置を用いた基板の処理方法に関する。

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0010】

この発明は、慣性力を低減できるようにするとともに、回転によって発生する遠心力の影響をほとんど受けることなく基板を保持できるようにしたスピン処理装置及びそのスピン処理装置を用いた基板の処理方法を提供することにある。

【手続補正 5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0014

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0014】

請求項 4 の発明は、上記回転体の外径寸法は、上記基板の外径寸法に比べて十分小さく形成されていることを特徴とする請求項 1 記載のスピン処理装置にある。

請求項 5 の発明は、基板を保持して回転させることで処理する基板の処理方法において

請求項 1 に記載されたスピン処理装置を用いて上記基板を処理することを特徴とする基板の処理方法にある。